

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

电力公用事业

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片。



认证



功能

专为使用带有以下插座的 Intel Core-i 处理器和 AMD 处理器的 ATX/ITX/Mini ITX 和 COM

产品而设计：Intel：LGA775、LGA1150、LGA1155、LGA1156、LGA1366、LGA2011；AMD：AM2、AM2(+), AM3、AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

兼容 Interscale C 型机箱

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片

用安装支架固定在 PCB 上，支架单独出售

技术参数

Table 1/1					
物料号	类型	搭配使用	包装数量	深度	宽度
24830-001	热导体	仪器箱	1	50 mm	50 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请订购用于将 FHC 装配到电路板上的安装支架（Intel 或 AMD，在“附件”部分中列出）。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE